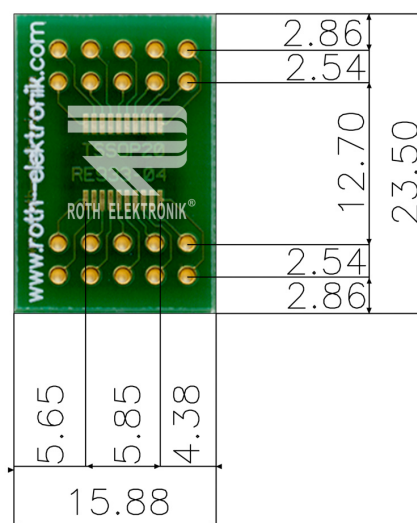




RE933-04

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionsplatine für TSSOP 20
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 15,88 x 23,50 mm

Modul-Nr.	Pitch	mil	Pin	Größe (mm)
RE933-04	0,650 mm	22,5	20	4,400 (173 mil)